

# 製品概要



インテル® Aero コンピュート・ボード  
インテル® Aero ビジョン・アクセサリ・キット  
インテル® Aero エンクロージャー・キット

## 3D ビジョンカメラを あなたのドローンへ

インテル® Aero ビジョン・アクセサリ・キットをインテル® Aero コンピュート・ボードに接続し、インテル® Aero エンクロージャー・キットに組み込み、それをお持ちのドローンに装着することで、迅速なアプリケーション開発とプロトタイプ作成が可能になります。



### インテル® Aero コンピューターボード

インテル® Aero コンピューターボードは、クアッドコアの Intel Atom® プロセッサーを搭載したドローン開発者、教育者、研究者向けの専用ドローン開発キットです。標準的なトランプカード・サイズにもかかわらず、豊富なストレージ機能、802.11ac Wi-Fi\*、インテル® RealSense™ カメラ R200(オプションのビジョン・アクセサリ・キットの一部)を含む複数のカメラのサポート、業界標準のインターフェイス、さまざまなドローン・ハードウェア・サブシステムへの接続を容易にするための再構成可能な I/O を備えています。オープンソースの Linux\* が組み込まれたコンピューターボードには、フライトおよびビジョン・インターフェイス用のサンプル・アプリケーションと API が用意されており、高度なドローン・アプリケーション開発におけるハードルを低減します。

### インテル® Aero ビジョン・ アクセサリ・キット

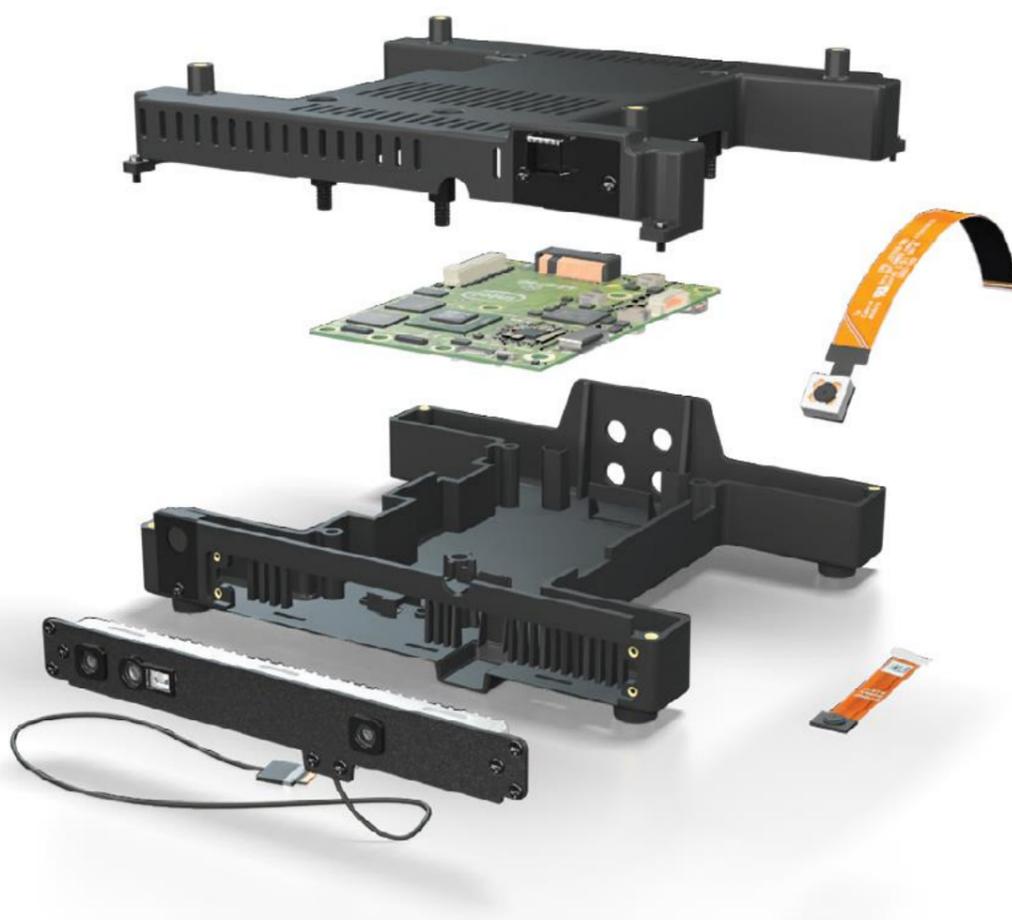
この 3 点のカメラキットには、障害物の感知および回避アルゴリズム開発のためのステレオ 3D イメージングとデプスセンシングを備えたインテル® RealSense™ カメラ R200、高解像度の写真およびビデオキャプチャーのための 8 MP RGB カメラ、オプティカル・フローアルゴリズム開発のためのグローバルシャッター・モノクロ VGA カメラが含まれています。これらのカメラは、付属のケーブルを使用し、専用の薄型コネクタを介してインテル® Aero コンピューターボードに直接接続されます。すべてのカメラには、Linux\* ドライバーが用意されています。

### インテル® Aero エンクロージャー・キット

このメカニカル・エンクロージャーは、インテル® Aero コンピューターボードと、インテル® Aero ビジョン・アクセサリ・キットに含まれる 3 点のカメラモジュールが収まるように設計されています。エンクロージャーは、2 ピースのプラスチック製アセンブリーであり、ほとんどのドローン機体に簡単に取り付けられることのできるマウント機能を備えています。完全に組み立てられた状態では、インテル® RealSense™ カメラ R200 と 8MP RGB カメラはともに、エンクロージャーの前面パネルに沿って収納されます。VGA カメラは、下向きのコンパートメントに収められます。そして、クリア・レンズ・カバーが 8MP カメラと VGA カメラの両方を保護します。



## 技術仕様



### インテル® Aero ビジョン・アクセサリ・キット

デプスセンシングと ビジョンカメラ	インテル® RealSense™ カメラ R200 (拡張ケーブル付属)
8 MP RGB カメラ	Omnivision* OV8858 (FPC 拡張ケーブル付属)
VGA カメラ	Omnivision* OV7251 (FPC 拡張ケーブル付属)

### インテル® Aero エンクロージャー・キット

外形寸法	X: 144.8 mm Y: 125.7 mm Z: 47.7 mm
重量	158 g
取り付け穴(4カ所)	間隔: 94 x 105.4 mm サイズ: M3 x 0.5

### インテル® Aero コンピュート・ボード

オペレーティング・システム	エンベデッド Linux* 4.4.3-yocto-standard、 Yocto Project* 2.1 (Krogoth)
BIOS	UAV 向けインテル® Aero プラットフォーム用に最適化 された Insyde Software 製 InsydeH2O* UEFI BIOS
プロセッサ	Intel Atom® x7-Z8750 プロセッサ
ディスプレイ	micro HDMI* 1.4b x 1
USB	USB 3.0 On-the-Go (OTG) コネクタ x 1
Wi-Fi*	インテル® Dual Band Wireless-AC 8260 (802.11ac)、 2x2 MIMO
メモリー	4 GB LPDDR3-1600
組み込みストレージ	32 GB eMMC
ストレージ拡張	microSD* メモリー・カード・スロット M.2 コネクタ-Pcie* x 1 レーン対応 SSD
カメラ・インターフェイス	MIPI* CSI-2 (4 レーン + 1 レーン)、 インテル® RealSense™ カメラ R200 専用 USB 3.0 ポート
I/O 拡張	FPGA GPIO (3.3V) x 28 および FPGA アナログ入力 x 5 (0~3 V) (インテル® MAX® 10 FPGA 経由でアクセス 可能)、プロセッサ-GPIO x 6、HSUART x 1、 CAN バス x 1
寸法	88 mm × 63 mm × 20 mm (ヒートシンク含む)
重量	30 g (ボードのみ)、60 g 未満 (ヒートシンク付きボード)



詳細については、<http://www.intel.com/aero/> (英語)を参照してください。

Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Atom、Intel RealSense、MAX は、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標です。

\* その他の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。

インテル株式会社

〒100-0005 東京都千代田区丸の内 3-1-1

<http://www.intel.co.jp/>

©2017 Intel Corporation. 無断での引用、転載を禁じます。

2017 年 7 月

336184-001JA  
JPN/1707/PDF/VGEL/Drone/RS